

國立交通大學
材料科學與工程學系
碩士論文

錫鉛焊錫接點在覆晶厚膜鎳/銅UBM結構上之電遷移

Electromigration of SnPb flip chip solder bumps with
thick Ni/Cu under bump metallization

研究生：陳俊宏

指導教授：陳 智

中華民國九十五年七月